大気圧プラズマを用いたアルミニウム蒸着膜の酸化処理に関する検討

江藤 亘平, 江口 陽人, 大前 洸斗

Surface Oxidation of Aluminum Thin Films by Atomic Pressure Plasma Kohei Eto, Takahito Eguchi and Hiroto Oomae

Abstract

The effect of atomic pressure plasma process time on evaporated aluminum thin films was studied. Process time was over the range 10-50 min. In the results, the roughness was increased with increasing process time. The thin films were peeled off during the process. The diffuse reflectance did not change after the exposure of plasma.

Keyword: Atomic pressure plasma, Aluminum thin films, Surface modification

1. はじめに

酸化アルミニウム(アルミナ)はαアルミナとγア ルミナの結晶構造を持つ.またそれらの非晶質である アモルファスアルミナがある.αアルミナのバンドギャ ップは9.5 eV [1],γアルミナは8.7 eV [2],アモルファ スアルミナは3.2 eV [3]と報告されている.結晶構造に かかわらず広いバンドギャップを有することから,ア ルミナは絶縁材料として広く利用されている.

蒸着したアルミニウム薄膜を酸化させる方法には、 熱酸化とオゾンによる酸化がある. 熱酸化の過程は、 $4Al+30_2 \rightarrow 2Al_2O_3$ が考えられる[4]. 450°C 以下では、 得られる酸化膜の厚さは 5 nm 程度であり、結晶構造も 無定形に近い. これに対して 500°C 以上では、 γ -Al_2O₃ の結晶性の酸化膜が厚く成長する. その厚さは数+ nm に達する. しかし、加熱を伴うため耐熱性でない基板上 に蒸着したアルミニウムの酸化には適用できない.

一方、オゾンの暴露では7nm ほどのアルミナ膜が得られると報告されている.酸化源である酸素原子 O,酸素 O₂、オゾン O₃のそれぞれの酸化電位は、2.42,1.23、2.07 V であり、酸素原子よりも安定なオゾンはフッ素に次いで酸化力が高いため、酸化膜を得るのに有用である.オゾンを生成するには、まず酸素分子 O₂を酸素原子 O に分解し、酸素分子 O₂と結合させる必要がある.O₂の解離エネルギーは 5.1 eV であるが、O₂を酸素原子に分解する方法として、誘電体バリア放電が知

られている[5]. 誘電体バリア放電はプラズマ放電の一 種で電極間の気体分子をイオン化させることができる.

誘電体バリア放電は、電極間に誘電体バリアを挟み、 その中に導入したガス中に高電圧を印加することで絶 縁破壊が起こり、電極から電極へ生じる放電のことで ある. 誘電体バリア放電では、パルス放電は10-100 ns しか持続しないため、アーク放電に移行する前に終了 するため発熱を伴わない[6]. また, ヘリウム He 中で誘 電体バリア放電をおこなうと安定で均一なグロー状の 放電が得られ、これを大気圧グロー放電と呼んでいる [7]. このときの印加電圧は数 kHz から数十 kHz の交流 電圧である. また, ガスには He の他に He で希釈した ガスを用いることができる[8]. 励起状態となった He に よりO2を分解し、オゾンを得ることができる.しかし、 アルミニウム薄膜をプラズマ中に置くことになるため, プラズマによる薄膜へのダメージが生じる問題がある. そこで本研究では、より厚いアルミナ膜を得ること を目的とし、長時間の大気圧グロー放電処理に対する アルミニウム薄膜の表面形状への影響について調べた.

2. 実験方法

処理対象であるアルミニウム薄膜は真空蒸着法を用 いてガラス基板上に堆積した. 放電のための高周波電 源にはインバータネオントランス (AN-10, 愛知電機株 式会社製型式)を用いた. インバータ方式で, 定格入力 電圧は100V,定格入力電流は0.8Aである.定格出力 電圧は20kVpp,周波数は20kHzである.印加電圧を 変圧器により変化させた.誘電体バリア間距離は5mm に固定した.プロセスガスはヘリウムと空気の混合ガ スである.評価には原子間力顕微鏡(AFM),走査型 電子顕微鏡(SEM),透過反射測定システムを用いた.

3. 実験結果

図1に試料表面のAFM 像を示す. 未処理のアルミニ ウム薄膜の表面は直径100 nm,高さ20 nm 程度の粒子 で覆われた形状となっている.30分までは処理時間が 増すごとに粒子が大きくなり直径300 nm,高さ100 nm 程度にまで成長することが確認できる.しかし40分以 降では表面形状の変化に違いが見られる.図2に処理 時間に対する表面粗さを示す.平均の表面粗さは処理 時間が20分まで増加し,その後減少していく.図.3に AFM で測定した試料の断面プロファイルを示す.処理 時間が30分までは処理時間が増すごとに表面が滑らか になっていき,40分以降は表面の変化が異なり,粗く なっている.プラズマ処理が表面形状に影響を与える こと,そして処理が短時間の場合と長時間の場合とで 膜の形状に与える影響が異なることを示唆している.

図4に試料の表面 SEM 像を示す. 倍率は5万倍であ る. 未処理のときには基板上に粒状のアルミニウムが 確認できるが, プラズマ処理が始まった後は表面が平 滑になっている. また, 30 分間と50 分間の処理を行な った試料の表面にはクラックが見られる. ここでは示 していないが長時間のプラズマ処理をした試料はアル ミニウムが部分的に剥離していたため, このクラック は薄膜が剥がれかけていることを示しているものと考 えられる.

図5に試料の断面SEM像を示す.未処理のアルミニ ウム薄膜は比較的平坦に堆積していることが分かる. 膜厚は約1µmと見積もられた.30分以下の処理では 薄膜の厚さはほとんど変化していないが,40分の処理 では膜の厚さが減少していることが分かる.この結果 から,長時間の処理では膜がエッチングされてしまう ることが分かった.

図6にアルミニウム薄膜の拡散反射率を示す. 拡散 反射率は処理時間に対してほとんど変化はない. また 透過率は測定波長域においてゼロであった. ここで得



 $1\mu m$

図1 アルミニウム薄膜の表面 AFM 像. プラズマ 処理時間は(a) 0min, (b) 10 min, (c) 20 min, (d) 30 min, (e) 40 min, (f) 50 min である.







図 3 AFM で測定したアルミニウム薄膜の断面プ ロファイル. プラズマ処理時間は(a) 0min, (b)10 min, (c) 20 min, (d) 30 min, (e) 40 min, (f) 50 min である.



図 4 アルミニウム薄膜の表面 SEM 像. プラズマ 処理時間は(a) 0 min, (b) 10 min, (c) 20 min, (d) 30 min, (e) 40 min, (f) 50 min である.



図5 アルミニウム薄膜の断面 SEM 像. プラズマ 処理時間は(a) 0 min, (b) 30 min, (c) 40 min である.



図6 アルミニウム薄膜の拡散反射率

られた表面形状の変化は光学特性にほとんど影響しないことを示している.

Behnke らは空気(酸素濃度 20%)をプロセスガスと して,誘電体バリア放電によりアルミニウムの酸化を 行った結果について報告している[9].電源の周波数は 10-25 kHz,電圧は<15 kV_{pp},ギャップ長は1.3 mm,プ ラズマ処理の時間は10分以内である.誘電体バリア放 電を用いることでアルミニウム表面の酸化膜が 3.2 nm から8.6 nm に増加すること,表面は数分間の処理で粗 さが増すことを報告した.我々の結果もBehnke らの結 果と同様であり,さらに処理時間が増すことで粗さが 増し,膜がエッチングされ,さらには部分的な剥離まで まで生じてしまうことが分かった.

4. まとめ

ガラス基板上に真空蒸着法で堆積したアルミニウム 薄膜に対して、大気圧グロー放電による表面酸化処理 を実施し表面形状の変化について調べた. AFM と SEM による表面及び断面形状観察の結果, 20 分以下の処理 で徐々に表面粗さが増加することがわかった. 一方, 40 分以上の処理では膜がエッチングされていくことが 分かった. また,表面処理の時間に対して拡散反射率 の変化はなく、光学特性への影響は表れなかった. 今 後,表面処理による薄膜へのダメージの軽減させつつ, 酸化膜を厚くするための検討が必要である.

謝辞

本研究を実施するにあたり、公益財団法人 池谷科学 技術振興財団 単年度研究の助成を受けた.

5. 参考文献

M. Schmid, M. Shishkin, G. Kresse, E. Napetschnig, P. Varga, M. Kulawik, N. Nilius, H.-P. Rust, H. J. Freund, Phys. Review Letter 97 (2006) 046101.

[2] B. Ealet, M. H. Elyakhloufi, E. Gillet, M. Ricci, Thin Solid Films 92 (1994) 250.

[3] I. Costina and R. Franchy, Appl. Phys. Lett. 78 (2001) 4139.

[4] 高橋英明, 表面科学 第9巻 (1988) 720.

[5] J. C. Devins, J. Electrochem. Soc. 103, (1956) 460.

[6] 高木浩一,藤原民也,栃久保文嘉, J. Plasma Fusion Res. **79** (2003) 1002.

[7] 田原充, Technical sheet No.07012 (2008).

[8] S. Kanazawa, M. Kogoma, T. Moriwaki and S. Okazaki, J. Phys. D: Appl. Phys. 21 (1988) 838.

[9] J. F. Behnke, H. Steffen, A. Sonnenfeld, R. Foest, V. Lebedev, and R. Hippler, Proceedings of the 8th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE 8), Tartu, Estonia **2** (2002) 410.